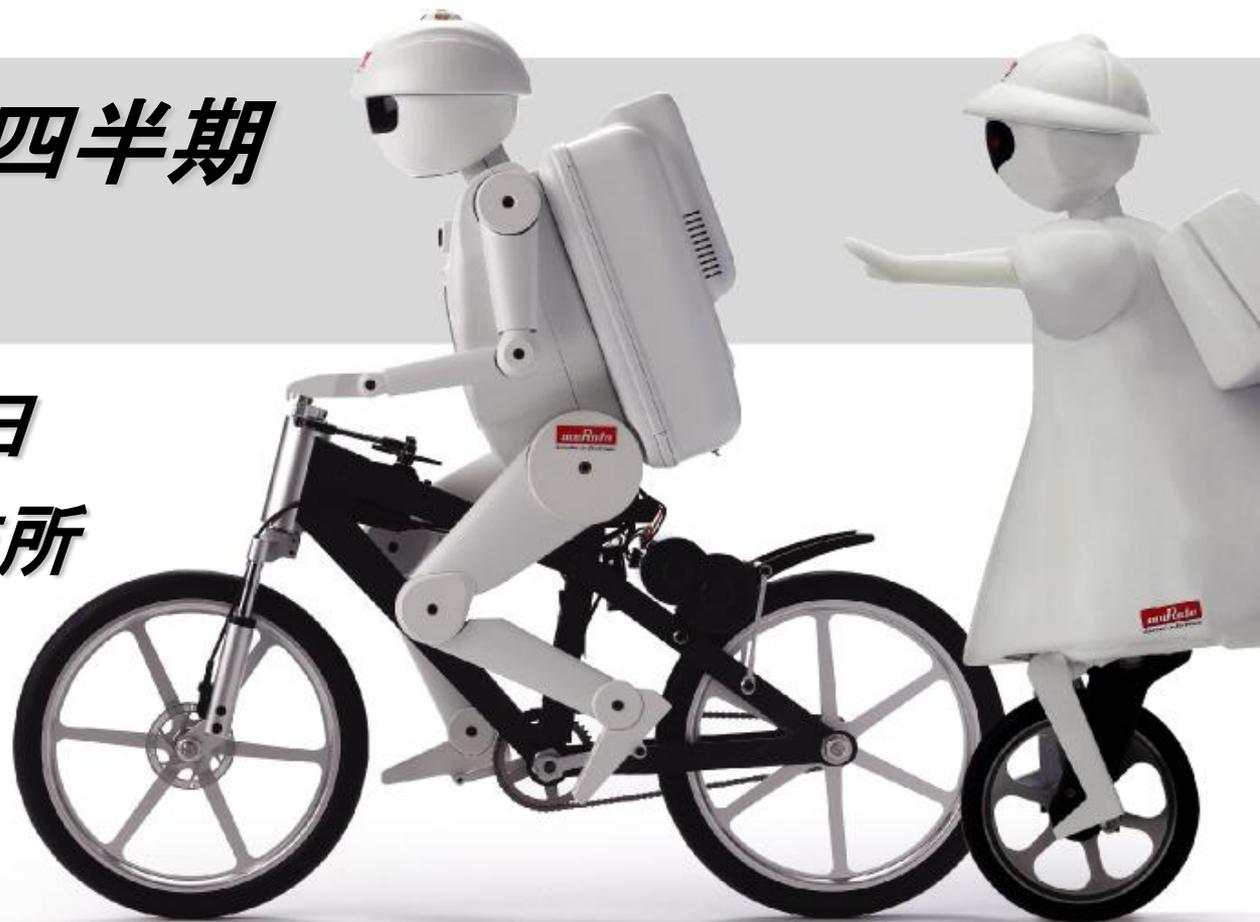


2010年度第2四半期 決算説明会

2010年10月29日
株式会社村田製作所



1. 2010年度 第2四半期業績概要

**2010年4月～2010年9月
第2四半期連結累計期間**

業績概況

	2009年度 上半期		2010年度 上半期				増減			
	(億円)	(%)	第1四半期 (億円)	第2四半期 (億円)	第1四半期 (億円)	第2四半期 (億円)	直前四半期比 10Q2/10Q1 (億円)	直前四半期比 10Q2/10Q1 (%)	前年同期比 10年上期/09年上期 (億円)	前年同期比 10年上期/09年上期 (%)
売上高	2,556	100.0	1,537	1,613	3,150	100.0	+76	+5.0	+594	+23.2
営業利益	61	2.4	215	248	463	14.7	+33	+15.2	+402	+658.3
税引前 四半期純利益	78	3.0	233	242	475	15.1	+9	+3.9	+397	+512.3
四半期純利益	47	1.9	155	156	311	9.9	+1	+0.9	+263	+555.0

製品別売上高

	2009年度 上半期		2010年度				増減			
	(億円)	(%)	第1四半期	第2四半期	上半期		直前四半期比 10Q2/10Q1		前年同期比 10年上期/09年上期	
(億円)			(億円)	(億円)	(%)	(億円)	(%)	(億円)	(%)	
コンデンサ	831	32.6	549	593	1,142	36.4	+44	+8.0	+311	+37.4
圧電製品	392	15.4	232	228	460	14.7	▲3	▲1.5	+68	+17.5
その他 コンポーネント	464	18.2	292	312	603	19.2	+20	+6.8	+139	+30.0
通信モジュール	645	25.3	320	339	659	21.0	+19	+5.8	+14	+2.2
その他 モジュール	215	8.5	138	136	274	8.7	▲3	▲1.9	+60	+27.7
製品売上高計	2,547	100.0	1,531	1,607	3,138	100.0	+76	+5.0	+592	+23.2

製品別売上高概況

(2009年度上半期→2010年度上半期)

<p>コンデンサ (前年同期比+37.4%)</p>	<p>＜チップ積層セラミックコンデンサ＞ セット台数増、員数増、品種構成良化(小型・大容量)により大幅増</p>
<p>圧電製品 (前年同期比+17.5%)</p>	<p>＜表面波フィルタ＞ 携帯電話・データカード台数増、員数増により大幅増 ＜セラミック発振子＞ 主力のカーエレ含む全用途大幅増 ＜ショックセンサ＞ HDD向け大幅増</p>
<p>その他コンポーネント (前年同期比+30.0%)</p>	<p>＜EMI 除去フィルタ＞ 通信機器、PC、カーエレ向け大幅増 ＜コイル、コネクタ＞ 携帯電話向けを中心に大幅増 ＜サーミスタ＞ 家電、スマートフォン、ノートPC向け大幅増</p>
<p>通信モジュール (前年同期比+2.2%)</p>	<p>＜無線LANモジュール＞ スマートフォン向けを中心に大幅増</p>
<p>その他モジュール (前年同期比+27.7%)</p>	<p>＜電源＞ 事務機器向けを中心に大幅増</p>

製品別売上高概況

(2010年度第1四半期→2010年度第2四半期)

コンデンサ (直前四半期比+8.0%)	<チップ積層セラミックコンデンサ> 携帯電話、AV向け大幅増
圧電製品 (直前四半期比▲1.5%)	<表面波フィルタ> 携帯電話、データカード向けを中心に大きく増加 <圧電スピーカ> 携帯メディアプレイヤー向け大幅減
その他コンポーネント (直前四半期比+6.8%)	<EMI 除去フィルタ> 全用途向けで堅調 <コイル、コネクタ > 携帯電話向けを中心に大幅増
通信モジュール (直前四半期比+5.8%)	<近距離無線通信モジュール> スマートフォン、携帯メディアプレイヤー、カーエレ向け大幅増 <多層デバイス> 携帯電話向け減少
その他モジュール (直前四半期比▲1.9%)	<電源> 通信機器、AV向け減少

用途別売上高

	2009年度 上半期		2010年度 上半期				増減			
	(億円)	(%)	第1四半期 (億円)	第2四半期 (億円)	(億円)	(%)	直前四半期比 10Q2/10Q1		前年同期比 10年上期/09年上期	
AV	407	16.0	202	228	429	13.7	+26	+12.9	+23	+5.6
通信	1,152	45.2	639	686	1,325	42.2	+47	+7.4	+173	+15.0
コンピュータ及び 関連機器	438	17.2	300	295	595	19.0	▲5	▲1.5	+157	+36.0
カーエレクトロニクス	293	11.5	195	199	395	12.6	+4	+2.1	+102	+34.9
家電・その他	257	10.1	195	198	394	12.5	+3	+1.5	+136	+52.9
製品売上高計	2,547	100.0	1,531	1,607	3,138	100.0	+76	+5.0	+592	+23.2

(注) 当社推計値に基づいております

用途別売上高概況

(2009年度上半期→2010年上半期)

<p>AV機器 (前年同期比+5.6%)</p>	<p>＜薄型テレビ＞ コンデンサ大幅増 ＜携帯メディアプレイヤー＞ 圧電スピーカ大幅減</p>
<p>通信 (前年同期比+15.0%)</p>	<p>コンデンサ、無線LANモジュール、表面波フィルタ、コネクタ、EMI除去フィルタ、コイル大幅増</p>
<p>コンピュータ及び 関連機器 (前年同期比+36.0%)</p>	<p>＜PC＞ コンデンサ、HDD衝撃検知用ショックセンサ、通信機器用モジュール、多層デバイス、EMI除去フィルタ大幅増 ＜事務機器＞ 電源大幅増</p>
<p>カーエレクトロニクス (前年同期比+34.9%)</p>	<p>セラミック多層基板、コンデンサ、バックソナー向け超音波センサ、ディーゼルエンジン向けアクチュエータ、セラミック発振子大幅増</p>

(注) 当社推計値に基づいております

用途別売上高概況

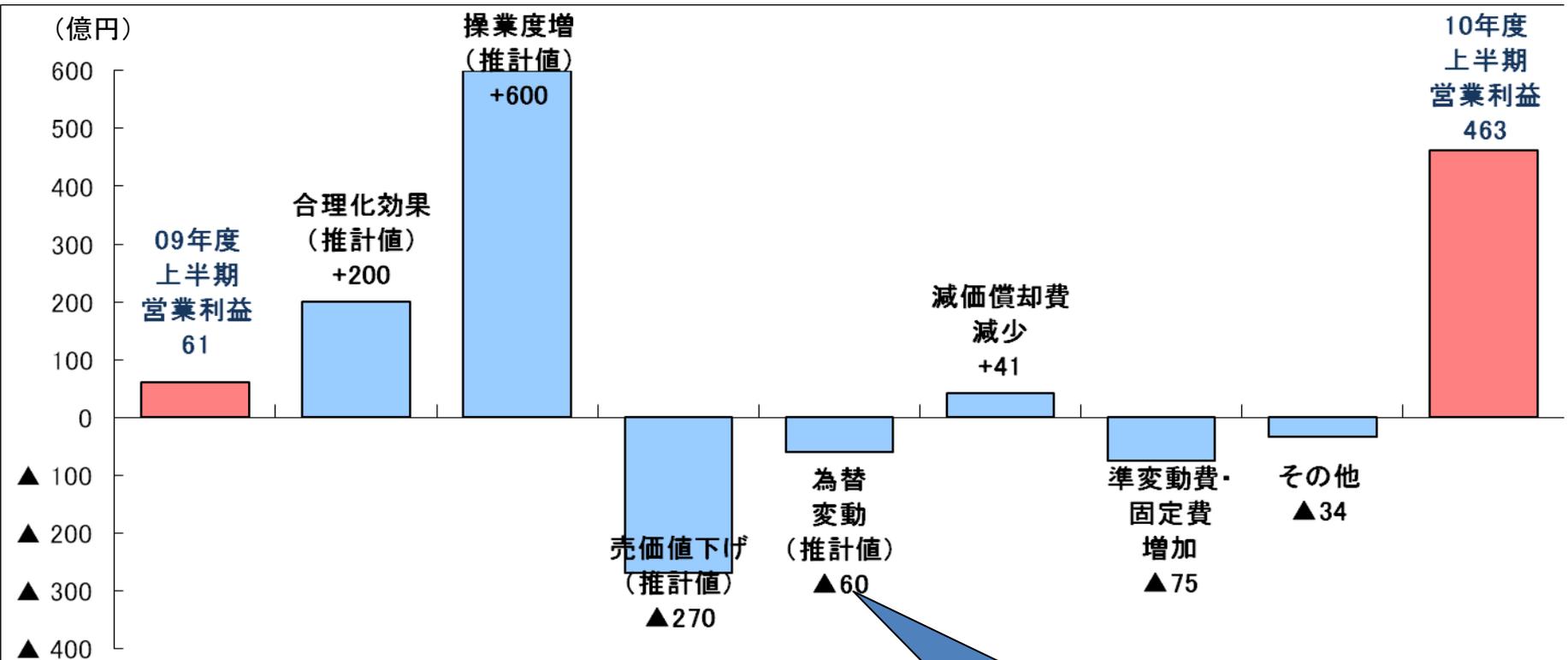
(2010年度第1四半期→2010年度第2四半期)

AV機器 (直前四半期比+12.9%)	＜携帯メディアプレイヤー＞ 無線LANモジュール大幅増 ＜ゲーム機＞ コンデンサ大幅増
通信 (直前四半期比+7.4%)	＜第3世代携帯電話＞ コンデンサ、無線LANモジュール、表面波フィルタ、コネクタ大幅増 多層デバイス減少
コンピュータ及び 関連機器 (直前四半期比▲1.5%)	＜PC＞ HDD衝撃検知用ショックセンサ大幅減
カーエレクトロニクス (直前四半期比+2.1%)	コンデンサ堅調

(注) 当社推計値に基づいております

利益変動要因

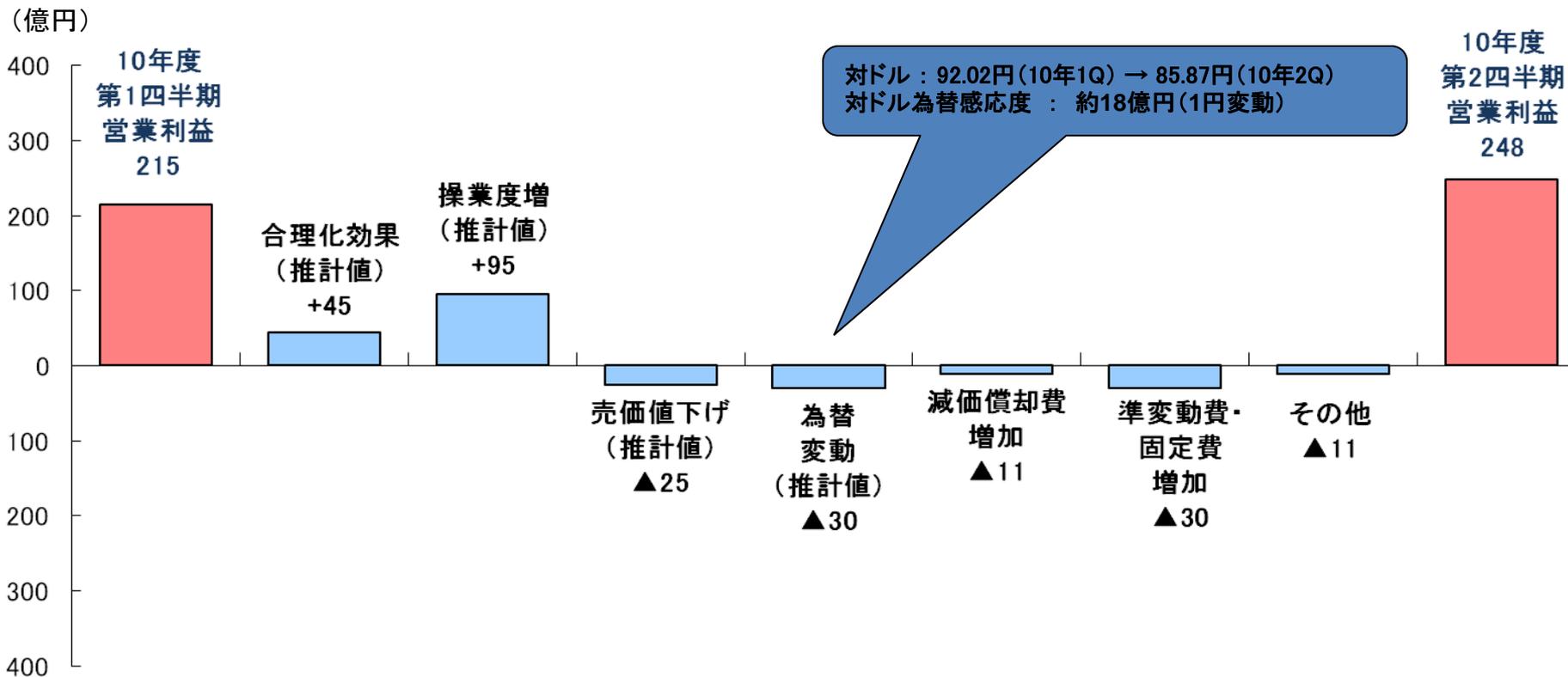
(2009年度上半期→2010年度上半期)



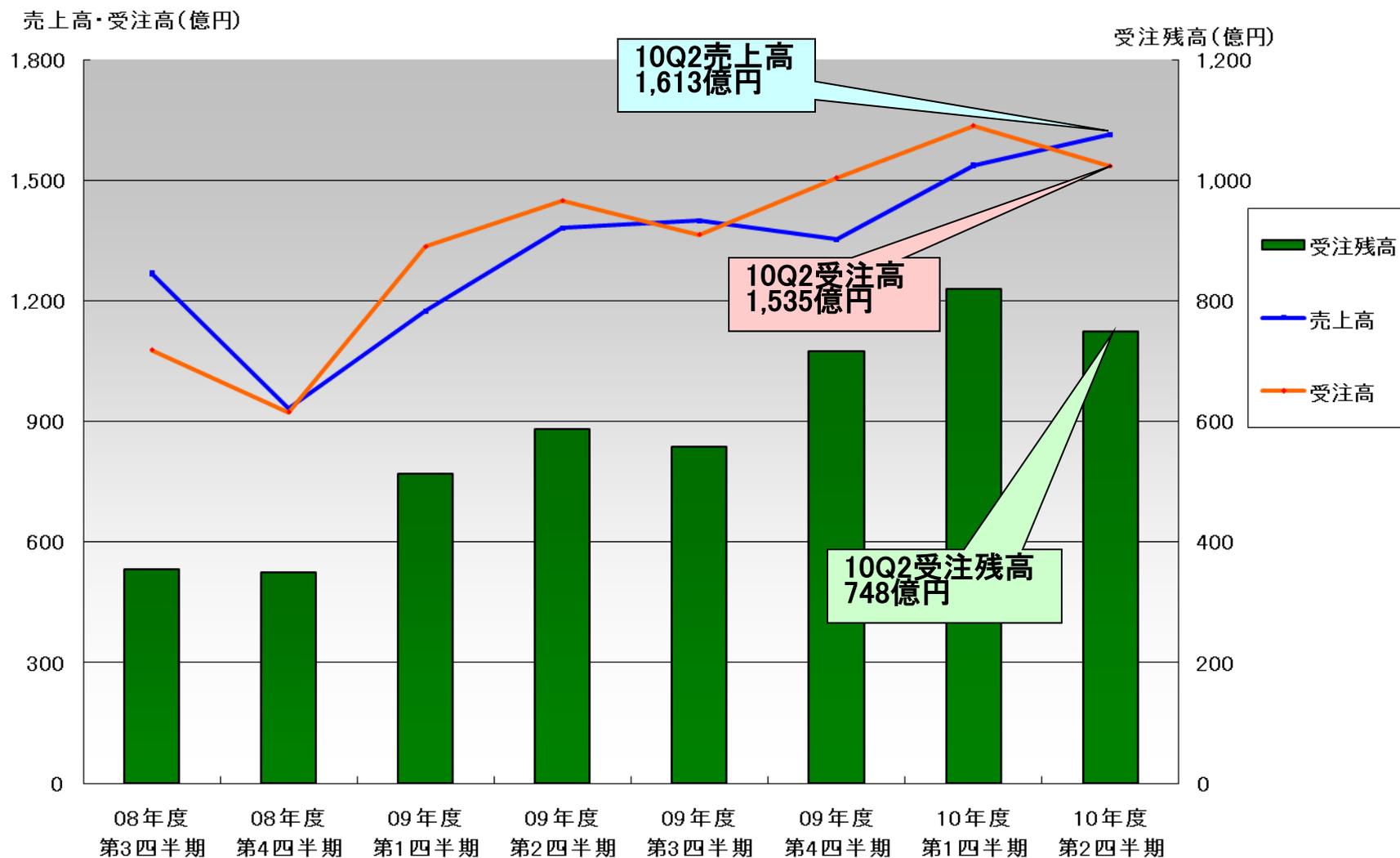
対ドル：95.49円(09年上期) → 88.95円(10年上期)
対ドル為替感応度：約18億円(1円変動)

利益変動要因

(2010年度第1四半期→2010年度第2四半期)



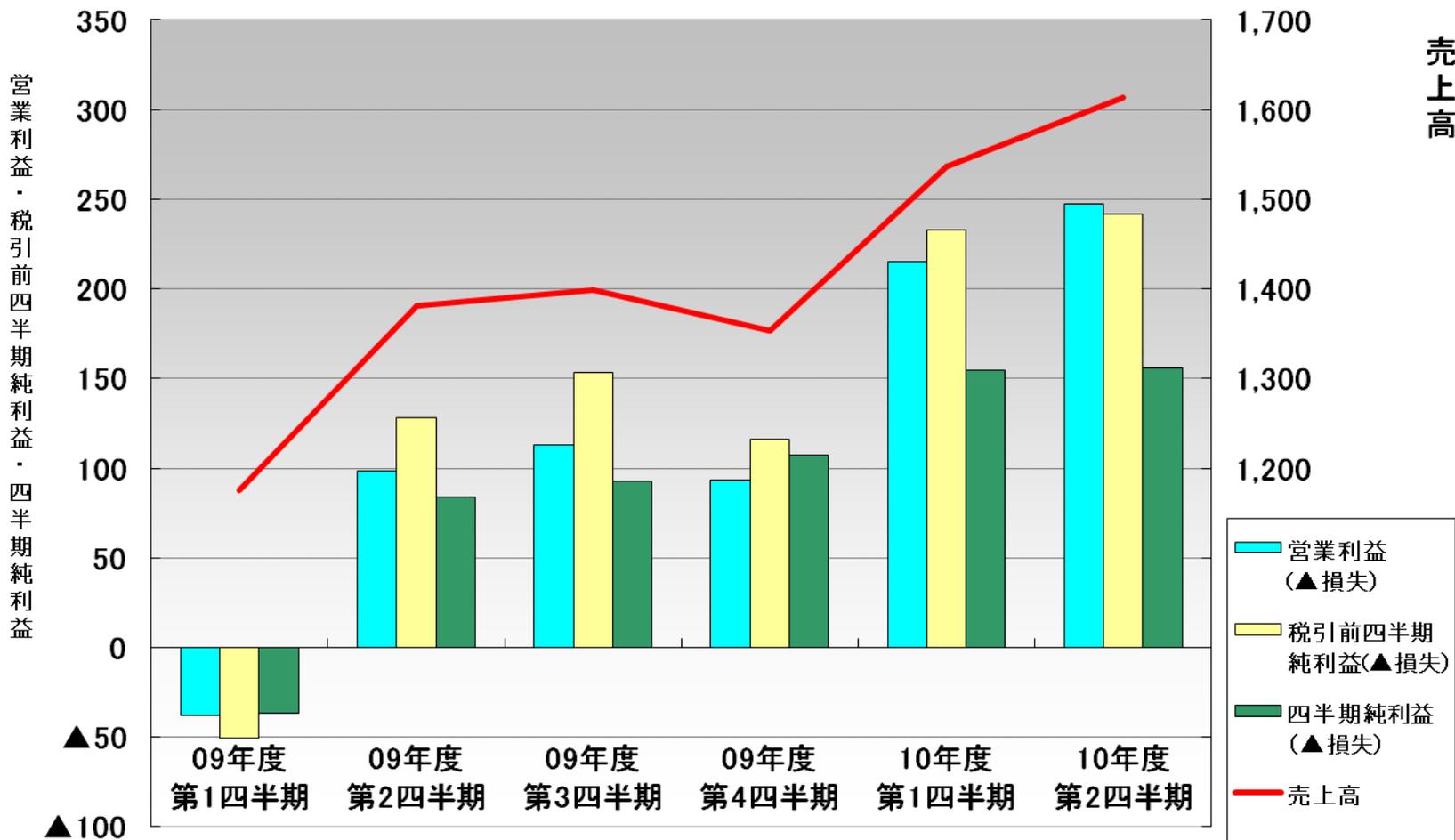
売上・受注・注残推移(四半期)



業績推移(四半期)

(億円)

(億円)



2. 2010年度 業績予想 (2010年4月～2011年3月)

部品需要予測(AV、通信)

薄型TV

1. 7億台(2009年度) → 2. 0億台(2010年度)
+18% 前回予想(10/4): 2. 2億台

携帯電話

12. 6億台(2009年度) → 14. 2億台(2010年度)
+13% ※前回予想(10/4): 13. 8億台

うち、

2G : 9. 3億台(2009年度) → 10. 0億台(2010年度)
+8% ※前回予想(10/4): 9. 5億台

3G : 3. 3億台(2009年度) → 4. 2億台(2010年度)
+27% ※前回予想(10/4): 4. 3億台

部品需要予測(PC及び関連機器)

PC

3.4億台(2009年度) → 3.5億台(2010年度)
+3% ※前回予想(10/4):3.9億台

うち、

ノートブック : 2.0億台(2009年度) → 2.1億台(2010年度)
+5% ※前回予想(10/4):2.5億台

デスクトップ : 1.4億台(2009年度) → 1.4億台(2010年度)
横這い ※前回予想(10/4):1.4億台

製品別売上予想

	2010年度 通期予想 (前年度比)	2010年度 下期予想 (上期比)
コンデンサ	+22%程度	▲8%程度
圧電製品	+5%程度	▲10%程度
その他コンポーネント	+20%程度	▲5%程度
通信モジュール	+10%程度	+5%程度
その他モジュール	+15%程度	▲5%程度
計	+16%	▲5%

用途別売上予想

	2010年度 通期予想 (前年度比)	2010年度 下期予想 (上期比)
AV	+3%程度	▲5%程度
通信	+16%程度	横這い
コンピュータ及び 関連機器	+25%程度	▲7%程度
カーエレクトロニクス	+13%程度	▲7%程度
家電・その他	+25%程度	▲10%程度
計	+16%	▲5%

(注) 当社推計値に基づいております

業績予想の前提

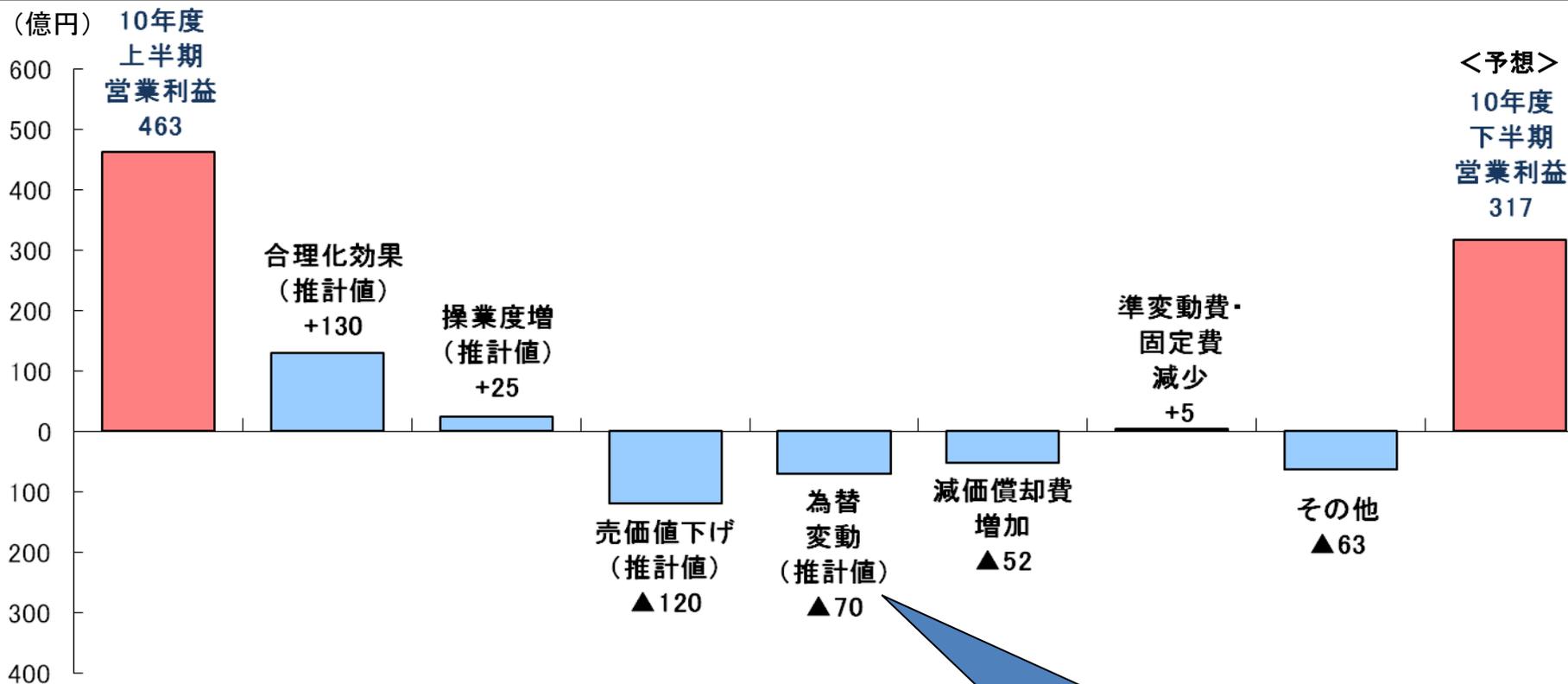
	2010年度 上期実績	2010年度 下期予想	2010年度 通期予想
減価償却費	294億円	346億円	640億円
研究開発費	202億円	208億円	410億円
設備投資額	208億円	312億円	520億円
為替レート(US\$)	88.95円/US\$	82.0円/US\$	
為替レート(EUR)	113.84円/EUR	110.0円/EUR	

2010年度 業績予想

	前回予想(10/7)			今回予想					
	2010年度			2010年度					
	上期予想	下期予想	通期予想	上期実績		下期予想		通期予想	
	(億円)	(億円)	(億円)	(億円)	(%)	(億円)	(%)	(億円)	(%)
売上高	3,150	2,900	6,050	3,150	100.0	3,000	100.0	6,150	100.0
営業利益	420	290	710	463	14.7	317	10.6	780	12.7
税引前 四半期純利益	460	310	770	475	15.1	335	11.2	810	13.2
四半期純利益	310	210	520	311	9.9	219	7.3	530	8.6

利益変動要因

(2010年上半期→2010年度下半期予想)



対ドル：88.95円(10年上半期) → 82.0円(10年下半期)
対ドル為替感応度：約20億円(1円変動)

当資料に記載されている、当社又は当社グループに関する見通し、計画、方針、戦略、予定、判断などのうち既に確定した事実でない記載は、将来の業績に関する見通しです。将来の業績の見通しは、現時点で入手可能な情報と合理的と判断する一定の前提に基づき当社グループが予測したものです。実際の業績は、さまざまなリスク要因や不確実な要素により業績見通しと大きく異なる可能性があり、これらの業績見通しに過度に依存しないようお願いいたします。また、新たな情報、将来の現象、その他の結果に関わらず、当社が業績見通しを常に見直すとは限りません。実際の業績に影響を与えるリスク要因や不確実な要素には、以下のものが含まれます。(1)当社の事業を取り巻く経済情勢、電子機器及び電子部品の市場動向、需給環境、価格変動、(2)原材料等の価格変動及び供給不足、(3)為替レートの変動、(4)変化の激しい電子部品市場の技術革新に対応できる新製品を安定的に提供し、顧客が満足できる製品やサービスを当社グループが設計、開発し続けていく能力、(5)当社グループが保有する金融資産の時価の変動、(6)各国における法規制、諸制度及び社会情勢などの当社グループの事業運営に係る環境の急激な変化、(7)偶発事象の発生、などです。ただし、業績に影響を与える要素はこれらに限定されるものではありません。

当資料に記載されている将来予想に関する記述についてこれらの内容を更新し公表する責任を負いません。